

证券代码：600360
债券代码：122134

证券简称：华微电子
债券简称：11 华微债

公告编号：2018-005

吉林华微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据本公司 2011 年 11 月 11 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]1350 号文批准，本公司于 2013 年 4 月在上海证券交易所采用非公开发行方式以每股 4.39 元的价格发行股票，共计发行人民币普通股 60,000,000 股。该次非公开发行股票共募集资金人民币 263,400,000.00 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 13,739,054.31 元后，实际募得资金为人民币 249,660,945.69 元。上述资金已于 2013 年 4 月 4 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的沪众会验字(2013)第 3594 号验资报告验证。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金得存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行帐号	截止日余额
中国农业银行吉林市分行大东支行	07-261001040019012	0.00

截止 2017 年 12 月 31 日，以上募集资金存储专户已正常销户。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

六英寸新型功率半导体器件扩产项目募集资金实际投资总额与承诺存在的差异系实际投资总额包含了募集资金利息收入再投入募投项目的款项，金额为 268.70 万元。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五)闲置募集资金情况说明

在使用募集资金期间，暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1)项目达产后第一年，市场销售情况不及预期，产品销售量相对于预测值偏低，从而影响了项目销售收入及效益水平。

(2)项目达产后第二年，由于市场竞争较为激烈，销售价格相对于预测值偏低。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截止至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			24,966.09			已累计使用募集资金总额：			25,234.80		
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：			25,234.80		
变更用途的募集资金总额比例：			0.00			2012 年：			0.00		
						2013 年：			15,991.94		
						2014 年：			9,242.86		
						2015 年：			0.00		
						2016 年：			0.00		
						2017 年：			0.00		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	六英寸新型功率半导体器件扩产项目	未变更	37,329.00	24,966.09 (注 1)	25,234.80 (注 2)	37,329.00	24,966.09 (注 1)	25,234.80 (注 2)	-268.70 (注 3)	2015 年 12 月 (注 3)	
2	电力电子器件硅外延片生产线项目	注 1	29,600.00	0.00 (注 1)	不适用	29,600.00	0.00 (注 1)	不适用	不适用	不适用	
	合计	—	66,929.00	24,966.09	25,234.80	66,929.00	24,966.09	25,234.80	-268.70		

注 1：公司前次发行实际募集资金 24,966.09 万元，低于计划募集资金总额，根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准的发行方案中关于“如

实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金的总金额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决”的相关规定，公司于2013年4月16日公告《募投项目后续安排说明》，根据发行预案对募集资金投资项目进行如下后续安排：

（1）公司将使用募集资金及部分自有资金完成“六英寸新型功率半导体器件扩产项目”。

（2）对于发行预案中的第二个项目，即：“电力电子器件硅外延片生产线项目”，公司将采取其他融资方式完成。

注2：根据募集资金项目竣工验收结果，该生产线项目实际总投资为30,090.56万元，超过募集资金及其利息收入合计25,234.80万元的部分为4,855.76万元，由公司自有资金投入。

注3：实际投资金额与承诺投资金额的差额：说明请详见下列“（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明”。

注4：根据前次非公开发行申请文件中的承诺，该项目的建设期为12个月，实际建设期为58个月，实际建设进度慢于计划进度主要是由以下几个原因造成的：

（1）为保证募投项目质量、提高生产的自动化程度，公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，对募投项目实施进行了优化完善。

（2）该募投项目所用主要设备来源于进口采购，公司就设备的供应商选择、价格谈判及后续设备安装未能按照预期完成。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 *1	承诺效益	最近三年一期实际效益*2				截止日 累计实现效益 *2	是否达到预 计效益*3
序号	项目名称			2014	2015	2016	2017		
1	六英寸新型功率半导体器件扩产项目	93.64%	达产第一年 3,970 万 达产第二年 4,906 万	-	-	1,750.10	2,724.99	4,475.09	否

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：承诺效益为税后净利润，实际效益为投资项目达到预计可使用状态至截止日期间的募集资金投资项目产品销售毛利扣除相关期间费用及所得税后的净利润，其中相关期间费用按照募投项目所产生的销售收入占公司整体销售收入的比重进行合理分配。。

注 3：累计实现收益低于承诺累计收益的说明详见（项目实现效益情况说明）。